

证券代码：688556

证券简称：高测股份

青岛高测科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	鹏华基金、中国人寿保险、海富通基金、华富基金、申万菱信基金、东吴证券、兴业证券、深圳铭海私募证券、国金证券、中银国际证券、上海国际信托、鸿运私募基金、野村东方国际证券、长江证券、国盛证券、国联民生证券、华福证券、申万宏源证券、狮城产业投资咨询(上海)、工银安盛资管、中银基金、浙商证券资管、上海宁泉资管、瑞银证券、广发证券、同泰基金、长沙美丰资管、财信证券、北京禹田资管、锂伟锂能投资、中邮证券、上海洛书投资、西安敦成私募基金、北京富智投资、华源证券、华泰保兴基金、浙商证券、上海齐熙投资、光大理财、汇华理财、上海睿量私募基金、天风证券、开源证券、深圳海盾赢华基金、深圳市坤厚私募基金、华西证券、富安达资管(上海)、华泰证券、信达证券、国华兴益保险资管、国泰海通证券、国海证券、长城财富保险资管、中国银河证券、海南世纪前沿私募基金、方正证券、杭州长谋投资、东北证券、北京中泽控股集团、民生通惠资产管理、博远基金、东吴基金、爱建证券、深圳小火资本、景合私募基金(海南)、上海仙人掌私募基金、路博迈基金、中信建投基金、山西证券、上海于翼资管、南方基金、上银基金、甬兴证券、西部利得基金、华能贵诚信托、上海喜世润投资管理、中德证券、鲁商基金、中金资管、安信基金、融通基金
时间	2026年3月31日
地点	公司会议室 线上
上市公司接待人员姓名	总经理 张秀涛先生 财务负责人 崔久华先生 董秘 王目亚先生 IR 经理 熊玉琳女士
投资者关系活动主要内容	
1、公司 2025 年业绩情况？ 2025 年，全球光伏新增装机量保持持续增长，但整体供需仍持续失衡，产能过剩与低效内卷竞争持续，各环节开工率维持低位，行业整体进入深度调整期。在反内卷政策推动下，虽然各环节价格有所	

回升，行业盈利能力适度修复，但企业生存依然承压。同时，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则计提相应减值准备。2025 年公司全年业绩虽然亏损，但季度环比持续改善，盈利能力快速修复，第三季度及第四季度均实现盈利。2025 年公司实现营业收入 36.50 亿元，同比下降 18.43%，实现归属于母公司股东的净利润-0.41 亿元，实现扣非后净利润-1.27 亿元，基本每股收益-0.05 元/股。其中第四季度实现收入 12.19 亿，实现归属于母公司股东的净利润 0.41 亿元，四季度盈利提升明显。

2、2025 年金刚线出货及盈利情况？

2025 年，公司实现冷拉钨丝母线产能快速扩充，钨丝金刚线细线化技术代差拉大，凭借钨丝金刚线产品差异化竞争优势，在金刚线市场整体需求量收缩情况下，仍实现了金刚线出货规模稳步增长。2025 年，公司实现金刚线销量（含自用）约 6700 万千米，其中钨丝金刚线约 5800 万千米，钨丝占比约 86.57%。金刚线销量（含自用）同比提升 13.56%，市占率实现大幅提升。同时，公司依托技术创新实现持续降本增效，并克服钨粉持续涨价等不利因素影响，实现了金刚线盈利能力逐步修复。

3、公司硅片切割加工服务出货规模及开工率情况？

公司充分发挥“设备+工具+工艺”融合发展及技术闭环优势，专业化切割成本优势凸显，克服行业整体开工率低迷等不利因素影响，凭借更高的出片数、更低的切割成本和更优的产品质量，硅片及切割加工服务业务订单稳步增长，实现开工率大幅优于行业，同时依托技术创新深耕降本增效，实现盈利逐步修复。2025 年公司硅片产量约 60GW，已跃居行业前五，渗透率快速提升至 8.82%（以上渗透率为按照 CPIA 统计数据 2025 年行业硅片产量 680GW 口径，公司自行测算结果）。

4、公司设备订单海外拓展进展？

公司聚力研发创新，加速设备升级迭代，凭借领先技术优势，产品获全球客户高度认可。2025 年，面对国内市场周期性调整，公司战略性发力海外，实现切割设备海外整厂交付，并落地技术服务及硅片切割代运营等新模式，构建“设备交付+技术服务+硅片切割代运营”的综合服务模式，推动从单一设备出口商向全球综合服务商转型，多维度满足客户深层需求。根据市场调研情况来看，2026 年海外市场订单机会较为充分，预计将对公司设备订单带来积极影响。

5、公司创新业务的发展情况？

依托在精密切割、精密研磨及电镀化学领域构建的平台化技术体系支撑，公司创新业务实现新品快速落地，产品矩阵持续完善。2025 年，公司泛半导体设备订单稳步增长，其中 8 寸半导体倒角机已获头部客户订单，8 寸碳化硅减薄机及 12 寸半导体金刚线切片机凭借领先的技术优势已进入客户试用阶段；3C 领域切割设备快速推向市场，并已形成批量订单；石材、磁材等产品海外订单实现突破并快速

增长，全球化供应能力持续提升。公司已具备泛半导体切磨倒一体化解决方案能力，并将持续提升产品竞争力，有效支撑公司创新业务未来稳步增长。

6、公司激光和钙钛矿产品布局？

公司始终聚焦光伏硅片切割环节深耕研发，在持续夯实硅片切割核心技术壁垒的同时，积极延伸光伏激光设备能力，并前瞻性储备钙钛矿电池关键技术，打造多维度技术曲线。2025 年公司积极整合外部资源联合开发激光类设备并快速推出设备新品，技术领先优势明显，获得海外客户高度认可，并获得批量订单。公司将持续提升激光设备性能，加速产品迭代，不断丰富产品矩阵；深入洞察光伏技术趋势，积极布局钙钛矿电池设备研发并储备钙钛矿电池工艺技术，已建立钙钛矿电池试验线并实现电池较高转换效率，公司将持续提升钙钛矿电池设备性能及工艺核心技术，实现电池转换效率持续突破。

7、公司超薄硅片切割技术优势？

公司充分发挥“设备+工具+工艺”融合发展及技术闭环优势，依托半片切割技术研发底蕴，持续优化半片切割工艺，积极储备超薄硅片切割技术。公司积极携手上下游企业，加快推进 80 μm 及 60 μm 硅片产业化应用的探索，加速推动矩形片、半片的规模化切割，已具备小批量交付 60-80 μm 硅片能力，并已领先行业推出 50 μm 及以下超薄硅片且开始送样测试。相较于成熟硅片，50 μm 及以下超薄硅片切割技术难度相对较高，对切片机精度控制、金刚线细线化及切割工艺等等都提出了新的要求，公司已明确超薄硅片良率持续提升路径，将助力行业加快超薄硅片量产节奏。

附件清单

无

日期

2026 年 4 月 3 日